

Micron collabora con Intel per migliorare il Knights Landing con una soluzione di memoria on-package ad alte prestazioni

La soluzione fornisce una memoria a basso consumo e ad ampia larghezza di banda per i sistemi informatici di prossima generazione

BOISE, Idaho, 23 giugno 2014 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU), uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni avanzate di semiconduttori, ha annunciato oggi che è in corso una collaborazione con Intel per fornire una soluzione di memoria on-package per il processore di prossima generazione Xeon Phi(TM) di Intel, nome in codice Knights Landing. La soluzione di memoria è il risultato di uno sforzo a lungo termine tra le due aziende per abbattere il muro della memoria, sfruttando le tecnologie fondamentali della DRAM e dello stacking che si trovano anche nei prodotti Hybrid Memory Cube di Micron.

"L'ecosistema sta cambiando e l'importanza di una memoria scalabile on-package e della sua larghezza di banda sta ora venendo alla luce", ha detto Chirag Dekate, Research Manager di IDC. "La memoria è al centro delle soluzioni riguardanti l'ingombro di spazio e andrà a vantaggio sia della grande elaborazione che del big data. Questo annuncio è una chiara convalida di come Micron stia portando avanti il ruolo e l'impatto della memoria nei sistemi ed il valore che la memoria 3D è in grado di fornire".

Fornendo una larghezza di banda pari a 5 volte quella fornita dalla DDR4, con un terzo di energia per bit ed un ingombro di spazio dimezzato, la soluzione ad alte prestazioni Knights Landing con memoria on package unisce la logica ad alta velocità con strati di DRAM in un unico pacchetto ottimizzato che definirà un nuovo punto di riferimento del settore per le prestazioni e l'efficienza energetica. Lo stack di memoria fornisce ottimi livelli di affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione, elementi critici per i sistemi di calcolo ad alte prestazioni. Una delle prime applicazioni del sistema Knights Landing - una nuova generazione di supercomputer Cray XC - è stata annunciata il 29 aprile da NERSC.

"Il processore di prossima generazione Intel® Xeon Phi™, nome in codice Knights Landing, potrà avere fino a 16GB di memoria on package ad alte prestazioni offrendo una larghezza di banda notevolmente maggiore di quella gestita dalle DDR4 e apportando una grande efficienza

di energia e risparmio di spazio. Si tratta del primo processore Intel HPC che utilizza questa nuova memoria on package ad alte prestazioni", ha detto Charles Wuischpard, Vice Presidente, General Manager, del gruppo Workstation e High Performance Computing Data Center di Intel. "Questo permetterà ai ricercatori, scienziati e ingegneri leader nel mondo di gestire maggiori carichi di lavori in maniera più veloce, pur mantenendo gli attuali impegni d'investimento. Siamo lieti di lavorare con Micron per ottenere questi risultati".

"L'architettura Many Integrated Core (MIC) di Intel e la memoria ad alte prestazioni di Micron sono una combinazione formidabile", ha detto Tom Eby, vice presidente del gruppo Compute and Networking Business Unit di Micron. "Le tecnologie avanzate di Micron e di Intel permettono di sposare con successo il processore con un sistema di memoria, ciò offre il raro accoppiamento del basso consumo con l'estrema larghezza di banda".

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di memoria ad alte prestazioni gestite da Micron, visitare il sito <http://www.micron.com/products/hybrid-memory-cube>.

Informazioni di carattere generale su Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc. è uno dei maggior fornitori al mondo di soluzioni avanzate per semiconduttori. Attraverso i suoi impianti di produzione a livello mondiale la Micron produce e commercializza una gamma completa memorie DRAM, memorie flash NAND e NOR, così come altre tecnologie di memoria innovative, moduli di memoria e sistemi a semiconduttori per l'uso in prodotti d'avanguardia, prodotti al consumo, per il networking, per la telefonia mobile e sistemi integrati. Le azioni ordinarie della Micron sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron Technology Inc., visitare il sito www.micron.com

(c)2014 Micron Technology Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Micron e il logo Micron sono marchi commerciali di proprietà di Micron Technology Inc. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti la disponibilità di memoria on package ad alte prestazioni. Eventi o risultati effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Micron su base consolidata, e in base alle scadenze periodiche, presso la Securities and Exchange Commission, in particolare al modulo 10-K e al modulo 10-Q depositati più recentemente dalla Micron. Tali documenti contengono e identificano alcuni

fattori importanti che potrebbero determinare risultati effettivi della Micron su base consolidata siano materialmente differenti da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali (vedi Determinati Fattori). Sebbene la società ritenga che le aspettative espresse nelle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, essa non può garantire i risultati futuri, i livelli di attività, prestazioni o realizzazioni.

CONTATTO: CONTATTO PR:

Greg Wood
Zeno Group for Micron Technology
650-801-7958
Greg.Wood@zenogroup.com